

<<电子工艺实训教程>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺实训教程>>

13位ISBN编号：9787111161370

10位ISBN编号：7111161378

出版时间：2005-1

出版时间：机械工业出版社

作者：夏西泉

页数：188

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺实训教程>>

内容概要

本书是21世纪高职高专电子信息类规划教材，也是电子信息类专业的公共基础课程。

本书的编写原则是：以理论够用为度，注重培养学生的基本实践技能。

本书主要内容包括：常用元器件的结构、主要参数、识别与判别；PCB设计基础、工艺流程、手工制作的方法与步骤；PCB焊接基础、手工焊接、浸焊操作要领与步骤；导线的加工工艺流程、焊接种类、形式和方法；常用表贴元器件的类型、主要参数、识别与判别，以及表贴元器件的贴焊工艺与表贴设备；电路板组装中元器件的加工与安装方法、整机组装中的连接种类及工艺过程；静、动态调试与I2C总线的调试内容、方法和步骤；整机装配工艺文件格式、整机调度内容与方法。

本书可供高职高专电子信息类专业的学生使用，也可供实践指导教师和有关专业的工程技术人员参考。

<<电子工艺实训教程>>

书籍目录

出版说明前言第1章 常用电子元器件 1.1 电阻器 1.2 电容器 1.3 电感器 1.4 半导体器件 1.5 电声器件 1.6 习题第2章 PCB的设计与制作 2.1 PCB设计基础 2.2 PCB设计实例 2.3 PCB制作的基本过程 2.4 PCB的生产工艺 2.5 PCB的手工制作 2.6 习题第3章 PCB的焊接技术 3.1 常用焊接材料与工具 3.2 焊接的条件与过程 3.3 PCB手工焊接 3.4 浸焊与波峰焊 3.5 新型焊接 3.6 习题第4章 导线加工与焊接 4.1 常用导线和绝缘材料 4.2 导线加工工艺 4.3 导线焊接工艺 4.4 习题第5章 表面贴装技术(SMT) 5.1 SMT概述 5.2 表面安装器件 5.3 SMC/SMD的贴焊工艺 5.4 表面安装设备介绍 5.5 表面安装设备介绍第6章 电子产品装配工艺第7章 电子产品调试工艺第8章 HS108-2型调幅收音机装调实例参考文献

<<电子工艺实训教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>